

UI Science Profile

迎接未來的設備

友藍科学株式会社

Profile of UI SCIENCE

Confidential

○社名 友藍科学株式会社

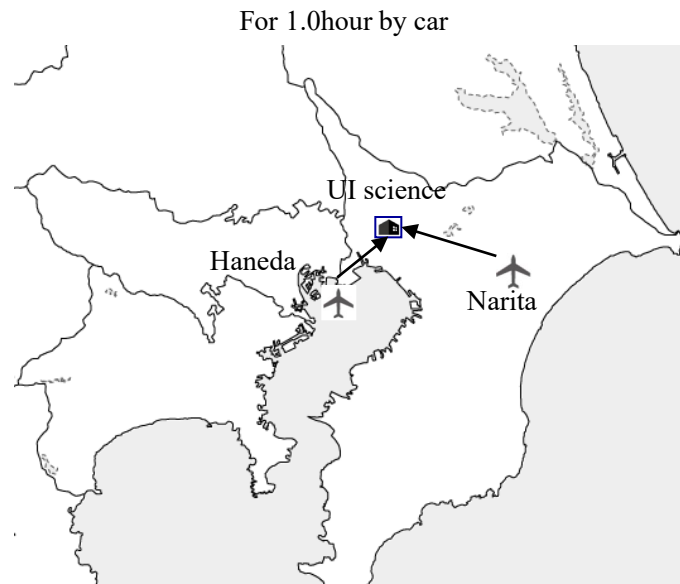
○住址 千葉県野田市七光台187-1
電話 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384

○公司簡介

創立	2016年 9月
資本金	¥100,000,000
主要來往銀行	千葉銀行・SMBC
代表取締役	梅本 伸一

○提供各種設備

捲式連接器選擇性電鍍設備
全自動晶圓 電鍍設備
半自動晶圓 電鍍設備
導線架 電鍍裝置 片式 或 捲式
掛鍍式、滾鍍式 電鍍設備
醫療機器設備、造船設備、實驗裝置
電鍍治具(各種電鍍治具、鑄造加工砂



Introduction of UI SCIENCE

Confidential

友藍SCIENCE 设备的未来方向

- 我司、累积20年的电镀设备经验,提供最先进技术的电镀设备专家。
- 我们的设备、是依照客户的需求与想法,完成客制化的专业设计成品。
- 我们的设备、将朝着替客户节省空间、节省能源、降低Running Cost 的目标而努力。

組織体制

役員(営業兼) 1名
経理、総務 3名
営業 1名
機械設計 4名
生産管理 2名
製造 6名
システム制御 2名

総員16名



Introduction of Plating equipment.

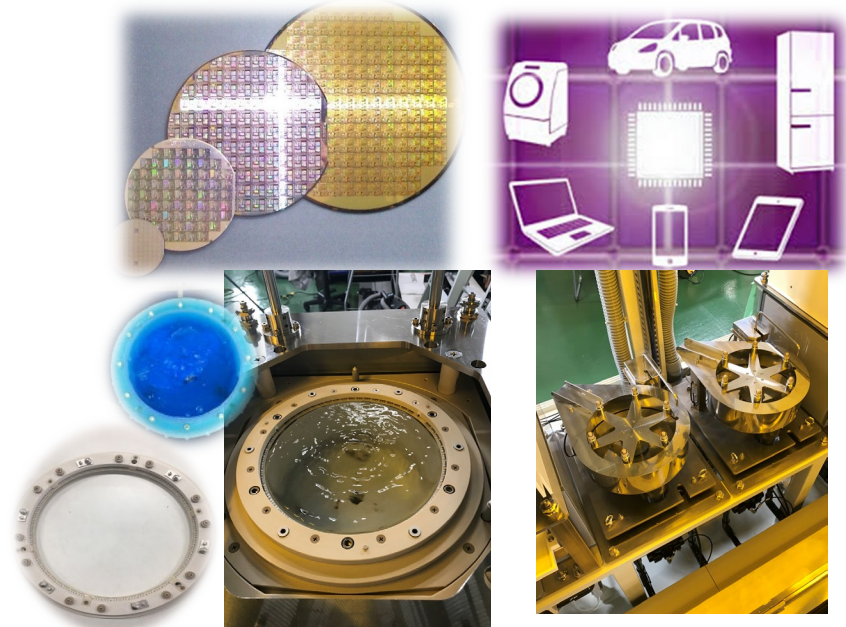
全自動 Wafer 電鍍設備

- 型號 : UIWA-03~012
- 電鍍 Cup 數 : 4~8 Cup(最多 8 Cup)
- 生產片數 : 約9000片/月
- 可鍍尺寸 : 3—4—5—6—8—12 inch
- 可鍍金屬 : Cu、Ni、Au、Sn
- 被鍍材料 : Si Wafer /GaAs Wafer
GaN Wafer / 其他材質 Wafer

○設備設計概念

- 搭載水平多軸式 Robot 安定搬送、可以得到穩定的品質
- 獨創的 Face down Cup 設計,可得到最高品質的電鍍效果
- 簡潔的設計及超省空間的概念
- 省能源,少維修

Confidential



(2018年Model 8inch-8cup-4SRD)

Introduction of Plating equipment.

半自動(手動上料)Wafer 電鍍設備

型號 : UIWM-03~012

電鍍 Cup 數 : 2~14Cup(最多 14Cup)

生產片數 : 約9000片/月

可鍍尺寸 : 3—4—5—6—8inch

可鍍金屬 : Cu、Ni、Au、Sn



Confidential

8inch Cu 4+4+2

8inch Cu 8+6

Introduction of Plating equipment.

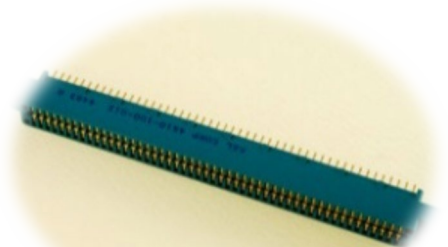
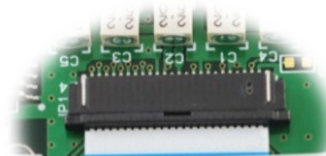
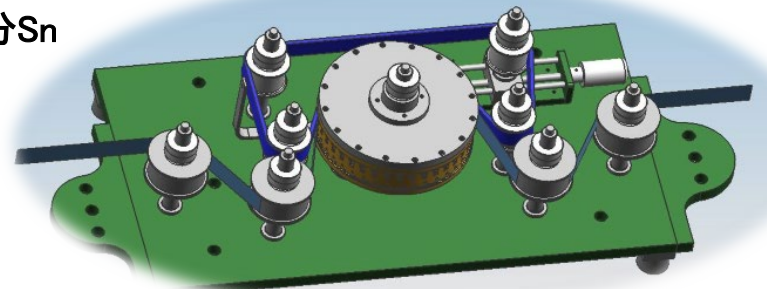
Confidential

捲式連接器部分選擇性電鍍設備

型號	: UIRC-02 ~04
列數	: 2列~4列(最多4列)
處理速度	: 1.0~25.0m/min
需求產品	: 連接器材、或線材
可鍍金屬選擇	: 全面Ni+部分Pd+部分Au+部分Sn : 全面Cu+全面Sn+Reflow ..等
被鍍材料	: Cu 合金、SUS ...等

○設備設計概念

- 超小間隙的微型連接器,由於機台的穩定性高、可以得到更好品質
- 車用型精密連接器生產時的穩定傳動、可以得到高品質的電鍍效果
- 提供各種部分電鍍治具加工,可以得到高精密度的品質效果
- 簡潔設計超省空間概念
- 省能源、少維修



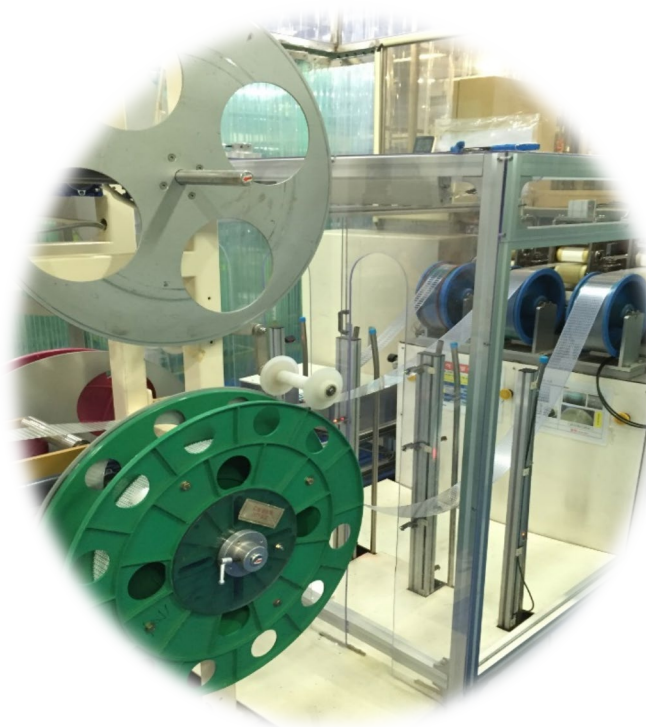
Introduction of Plating equipment.

Confidential

導線架電鍍設備

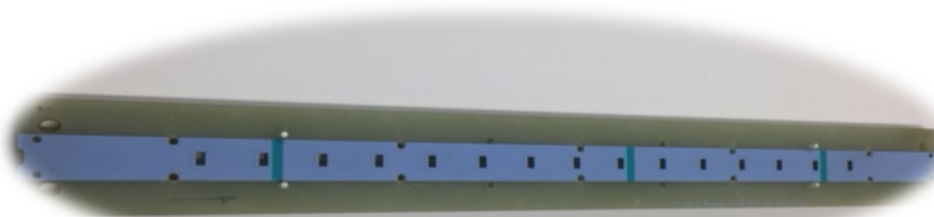
捲式部分選擇性電鍍機

型號	: UIRLF-02 ~04
列數	: 2列~4列(最多4列)
處理速度	: 2.0~5.0m/min
被鍍材料	: Cu 材, 42合金 及其他
可鍍金屬	: Cu、Ni、Ag、Au、Sn



○設備設計概念

- 獨創的電鍍模具(RDV Type),可以得到最高品質的電鍍效果
- 點狀電鍍的精度可達 ± 0.07 以下
- 簡潔的設計,操省空間的概念
- 省能源,少維修



Introduction of Plating equipment.

Confidential

導線架電鍍設備

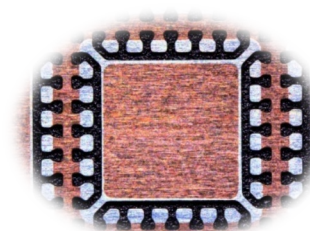
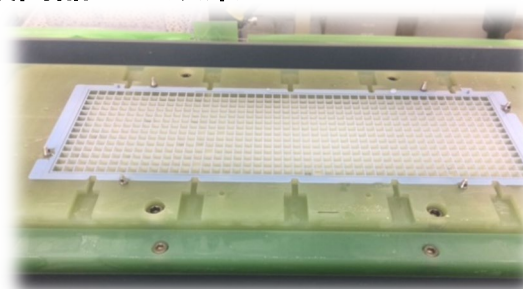
片式部分選擇性電鍍機

型號	: UICLF - 04 or 06
列數	: 4列(最多 6列)
處理速度	: 1.6 ~ 2.0m/min
被鍍材料	: Cu 材, 42合金 及其他
材料尺寸	寬 : 20 ~ 110 mm 長 : 120 ~ 300 mm 厚 : 0.10 ~ 0.25 mm
可鍍金屬	Cu、Ni、Ag、Au、



○設備設計概念

- 獨創的電鍍治具(RDV Type),可得到最高品值的效果
- 點狀電鍍精度 ± 0.05 以下
- 簡潔的設計及超省空間的概念
- 省能源、少維修



Introduction of control system

Confidential

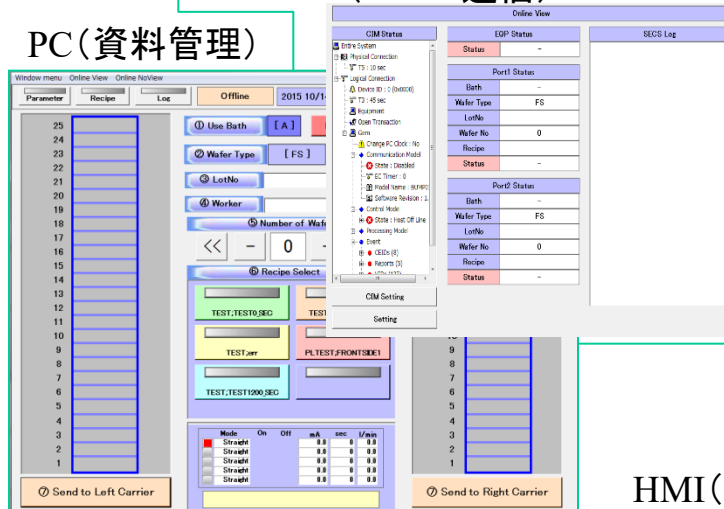
本公司的各種控制設備,都可由
多樣化的網路傳輸來操控機器。
實現了能在生產線上直接控制的願望。



客製化HOST serve
SECS/GEM

On line (HOST通信)

PC (資料管理)



- 設備控制 (輸送、Robot 操控等)
- レシピD/L、data收集、警報履歴管理 (PC控制)
- レシピU/L、主動通信管理 (線上直接控制)

PLC (設備制御)

PLC (設備制御)



Melsecnet/H

設備間通訊



...

Ethernet

HMI (設備控制)

CC-Link

FA通訊



水平多關節 Robot (多軸型)



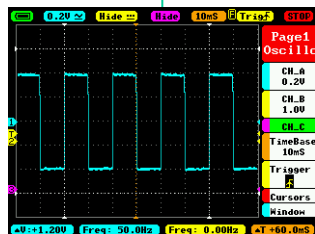
Ethernet

多功能画像検査装置



In line 画像検査

Ethernet



電流控制基板操控、噴流控制等

RS-232C通信

Access to UI SCIENCE

Confidential

本社工場

〒278-0051 千葉県野田市七光台187-1

187-1 Nanakoudai, Noda City, Chiba Prefecture,

〒278-0051, Japan

最寄り駅 東武アーバンパークライン

川間駅よりタクシーで10分

最寄インター 常磐道柏インターより車で40分



入間工場

〒278-0051 埼玉県入間市宮寺4079-8

最寄り駅 西武池袋線

入間市駅よりタクシーで20分

最寄インター 圏央道入間インターより車で15分

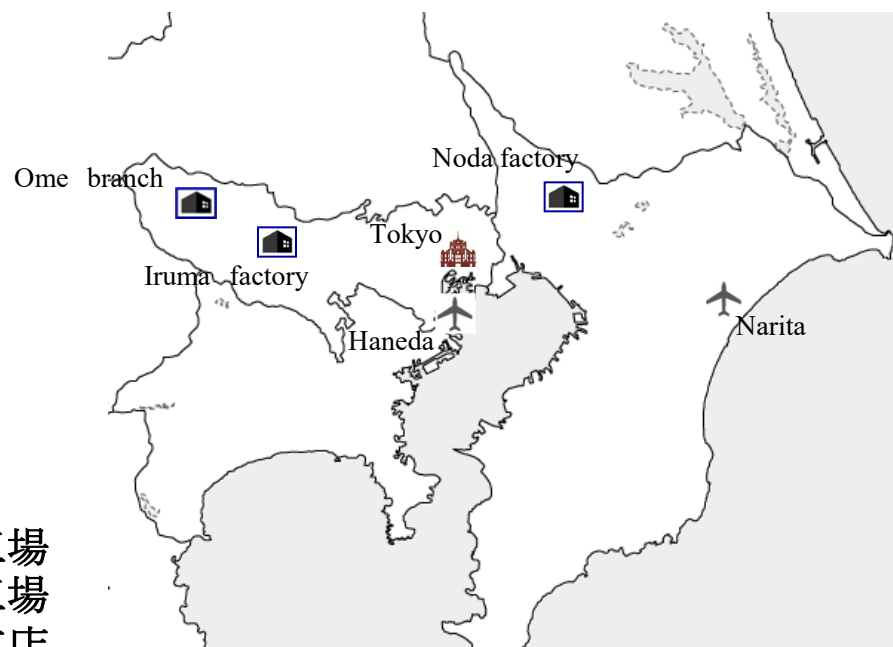
青梅支店

〒198-0023 東京都青梅市今井5-2477-44

最寄り駅 JR青梅線

青梅駅よりタクシーで30分

最寄インター 圏央道青梅インターより車で10分



本社事務所・野田工場
半導体設備 入間工場
樹脂加工 青梅支店